

Elephantech

AgIC フレキシブル基板のブランド名変更のお知らせ 新ブランド名は「P-Flex®」

2017年7月31日

プリントド・エレクトロニクス技術を開発するAgIC株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：清水信哉、以下AgIC）は、ピュアアディティブ®法で製造されたフレキシブル基板のブランド名を「AP-2」から「P-Flex®」に変更しました。

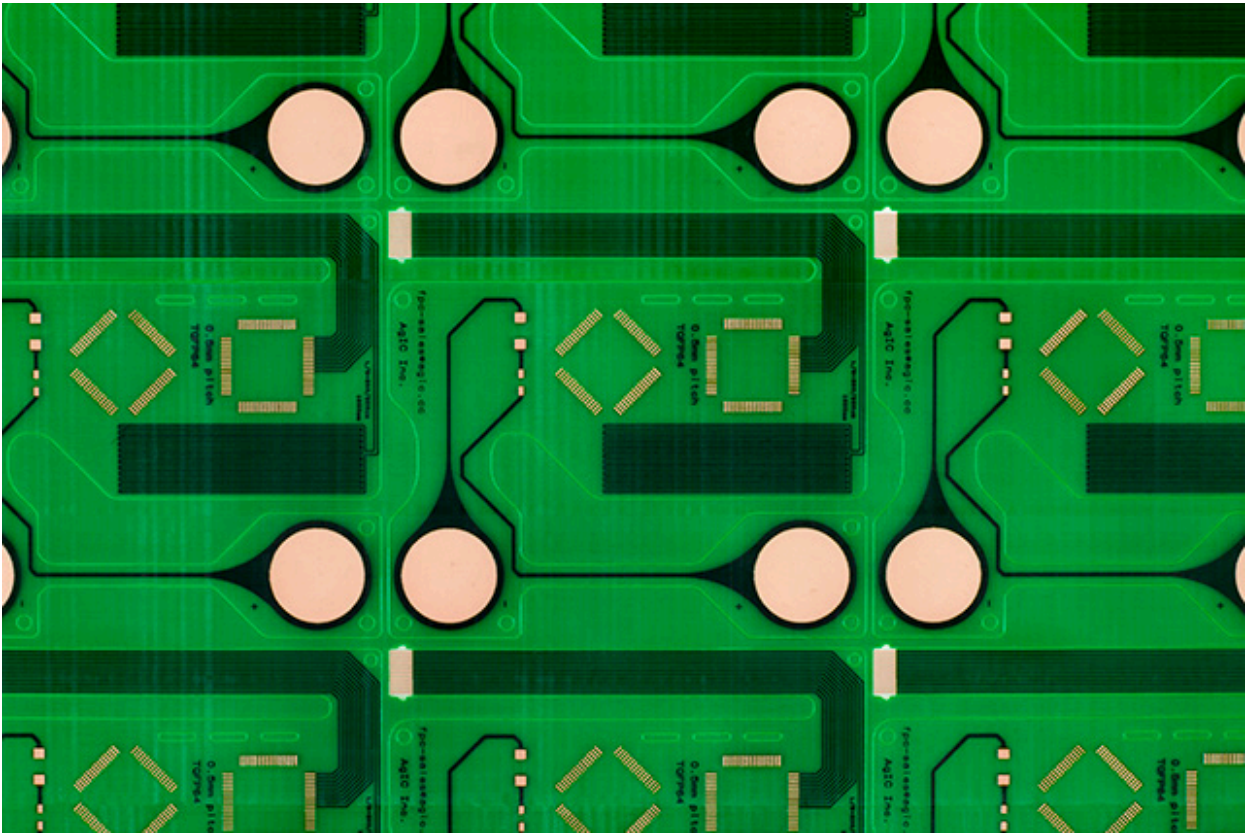
変更に伴い、新たにP-Flex®のロゴも作成いたしました。

P-Flex®ロゴ

P-Flex®の「P」は

- ・AgIC独自のフレキシブル基板製造法であるピュアアディティブ®(※)法の「Pure additive」
 - ・”印刷技術で、ものづくりに革命を”の「Printed」
- のそれぞれの頭文字の「P」に由来します。

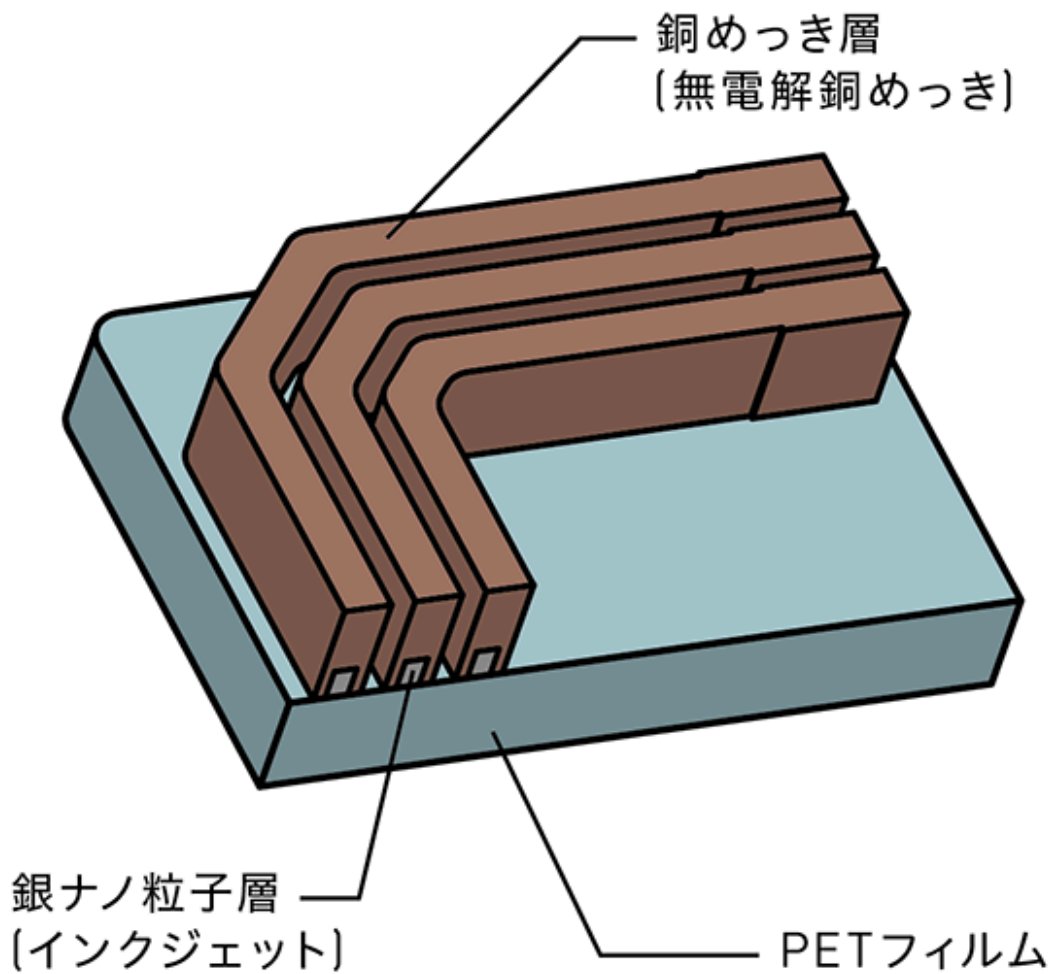
今後は、オンデマンドに加えて個別対応サービス、実装対応などさらにサービスを広げていく予定です。



P-Flex®

(※)ピュアアディティブ® (Pure additive)法とは

ピュアアディティブ®法は、必要な部分にのみインクジェットで金属を印刷し、さらにめっき技術で金属を成長させるというこれまでとは全く逆の発想のフレキシブル基板の製造方法です。この方法は、必要な材料、工程を削減することができ、これにより大幅なコスト削減を実現します。そのために、小ロットや試作にも対応でき、特に少量試作ではコストを5分の1以下に抑えることができます。



※見やすくするために厚さ方向に拡大して図示しています

ピュアアディティブ®法

- 🔗 P-Flex® 製造仕様
- 🔗 ピュアアディティブ®法製造工程
- 🔗 フレキシブル基板の製造方法の違い

製造仕様

基材	透明耐熱PETフィルム 125 μm厚
最小パターン幅/間隔 (L/S)	200/200 μm (200/150 μmも近日対応予定)
最小穴径	1.0 mm
外形-パターン最小間隔	0.5 mm
銅膜厚	3 μm (6 μm, 9 μmも近日対応予定)
最大外形サイズ	180 × 270 mm
配線層	片面のみ

レジスト塗布	UVインクジェット印刷方式（緑色）
シルク印刷	UVインクジェット印刷方式（黒色）
表面処理	酸化防止処理、無電解ニッケル金めっき（追加費用・納期で対応）
外形加工	レーザーカット対応
穴加工	レーザーカット対応
補強板	対応（総厚300μm）
検査	外観検査 + オープンショートテスト

会社概要

名称	AgIC 株式会社
代表	代表取締役 清水信哉
設立	2014年1月
資本金	2億4070万円（資本準備金を含む）
所在地	東京都文京区本郷 5-25-18, ハイテク本郷ビル 1F
URL	http://agic.cc/
事業内容	プリントド・エレクトロニクス製造技術の開発、サービス提供

2017年7月31日現在

本件に関するお問い合わせ先

<https://www.elephantech.co.jp/products/pflex/>

AgIC株式会社 P-Flex® 担当窓口

メールアドレス : fpc-sales@elephantech.co.jp